



(43) 國際公開日
2005 年 7 月 14 日 (14.07.2005)

PCT

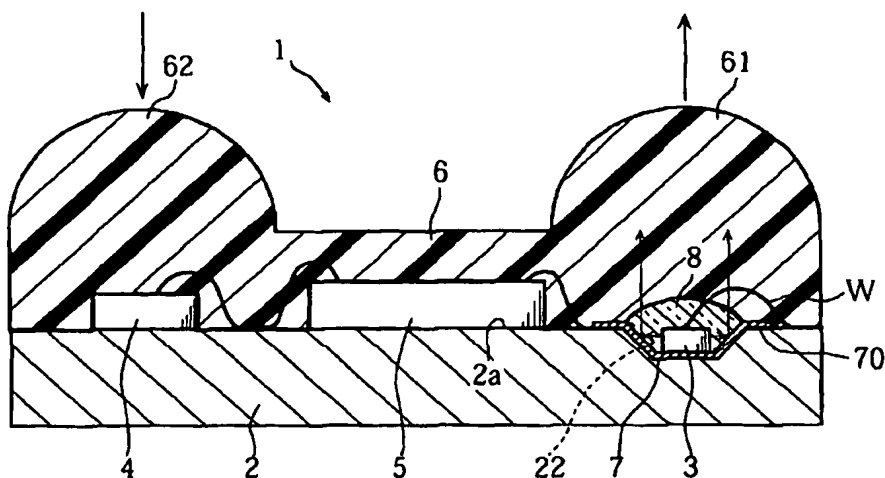
(10) 国際公開番号
WO 2005/064689 A1

- | | | |
|--|-----------------------------|---|
| (51) 国際特許分類: | H01L 31/02, 31/12 | (74) 代理人: 吉田 稔 . 外(YOSHIDA, Minoru et al.);
〒5430014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町2番
32-1301 Osaka (JP). |
| (21) 国際出願番号: | PCT/JP2004/019090 | |
| (22) 国際出願日: | 2004年12月21日 (21.12.2004) | (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW. |
| (25) 国際出願の言語: | 日本語 | |
| (26) 国際公開の言語: | 日本語 | |
| (30) 優先権データ:
特願 2003-429322 | 2003年12月25日 (25.12.2003) JP | (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, |
| (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ローム
株式会社 (ROHM CO., LTD.) (JP/JP); 〒6158585 京都
府京都市右京区西院溝崎町2 1 番地 Kyoto (JP). | | |
| (72) 発明者; および | | |
| (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 堀尾 友春 (HO-
RIO, Tomoharu) (JP/JP); 〒6158585 京都府京都市右京
区西院溝崎町2 1 番地 ローム株式会社内 Kyoto (JP). | | |

〔統葉有〕

(54) Title: OPTICAL DATA COMMUNICATION MODULE

(54) 発明の名称: 光データ通信モジュール



(57) Abstract: Disclosed is an infrared data communication module (1) comprising an infrared light-emitting device (3), an infrared light-receiving device (4) and an IC chip (5). The light-emitting device (3), light-receiving device (4) and IC chip (5) are mounted on a substrate (2) and covered with a sealing resin package (6). The substrate (2) is provided with a recessed portion (22) whose inner surface is covered with a ground-connected metal film (7), and the light-emitting device (3) is arranged in the recessed portion (22).

(57) 要約: 赤外線データ通信モジュール1は、赤外線発光素子3、赤外線受光素子4、およびICチップ5を備えている。発光素子3、受光素子4、およびICチップ5は基板2に搭載されて封止樹脂パッケージ6により覆われている。基板2には、グランド接続された金属膜7によって内面が覆われた凹部22が形成されており、かつこの凹部22内に、発光素子3が配されている。

WO 2005/064689 A1